



**平成22年3月期
(第8期)
第2四半期決算説明会**

**平成21年11月5日
株式会社ジーダット**

上期実績と通期見通しのポイント

上期は計画比売上高 Δ 12%、経常利益 Δ 79%

通期は計画比売上高 Δ 11%、経常利益 Δ 77%

研究開発投資は、ほぼ計画通り継続

新製品開発・リリースは、ほぼ計画通り

更なる固定費圧縮により、経常利益黒字を確保

上期実績 - 前年同期比・計画比 -

(単位:百万円)

| | 平成21年3月期 | 平成22年3月期 | | | |
|----------------|----------|----------|-----|--------------------|-------|
| | 実績 | 当初計画 | 実績 | 前年同期比 | 当初計画比 |
| 売上高 | 1,234 | 790 | 694 | △44% | △12% |
| 売上総利益 | 909 | 539 | 464 | △49% | △14% |
| 販売費及び 一般管理費 | 613 | 538 | 515 | △16% | △4% |
| 営業利益 | 295 | 1 | △51 | | |
| 経常利益 | 322 | 32 | 6 | △98% | △79% |
| 特別損失 | — | — | 14 | 固定資産除却損 事業所移転費用 | |
| 当期純利益 | 215 | 20 | △4 | | |

通期見通し -前年同期比・計画比-

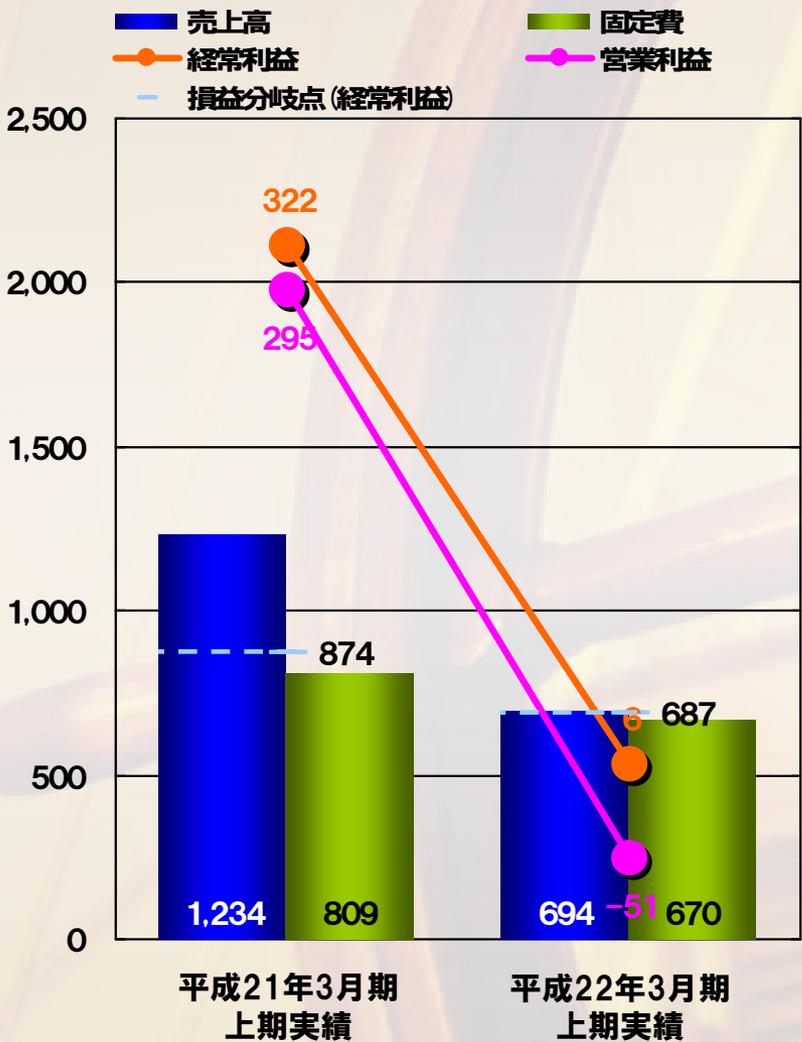
(単位:百万円)

| | 平成21年3月期 | 平成22年3月期 | | | |
|----------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | 実績 | 当初計画 | 見通し | 前年同期比 | 当初計画比 |
| 売上高 | 2,074 | 1,630 | 1,450 | △30% | △11% |
| 売上総利益 | 1,474 | 1,119 | 966 | △34% | △14% |
| 販売費及び 一般管理費 | 1,247 | 1,117 | 1,066 | △14% | △5% |
| 営業利益 | 227 | 2 | △100 | | |
| 経常利益 | 264 | 85 | 20 | △92% | △77% |
| 特別損失 | — | — | 14 | | |
| 当期純利益 | 58 | 50 | 0 | | |

売上高・利益 - 前年同期比 -

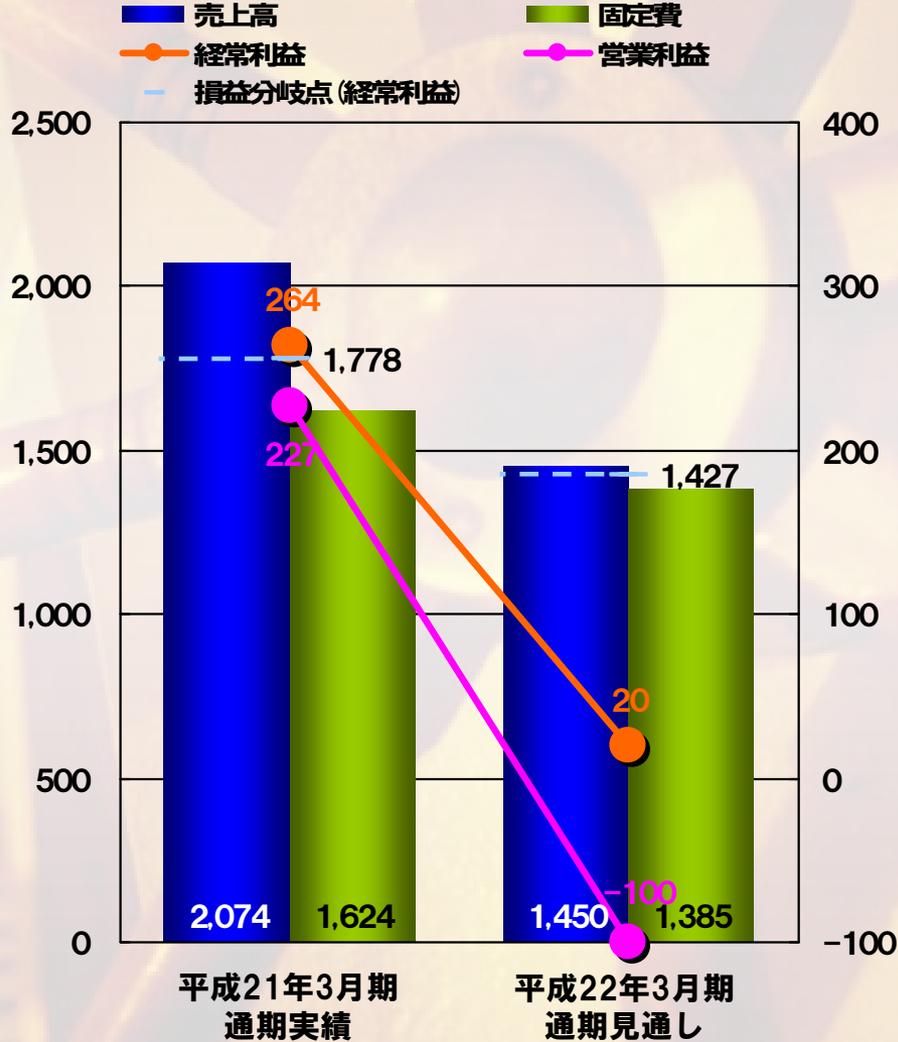
【半期比】

(単位:百万円)



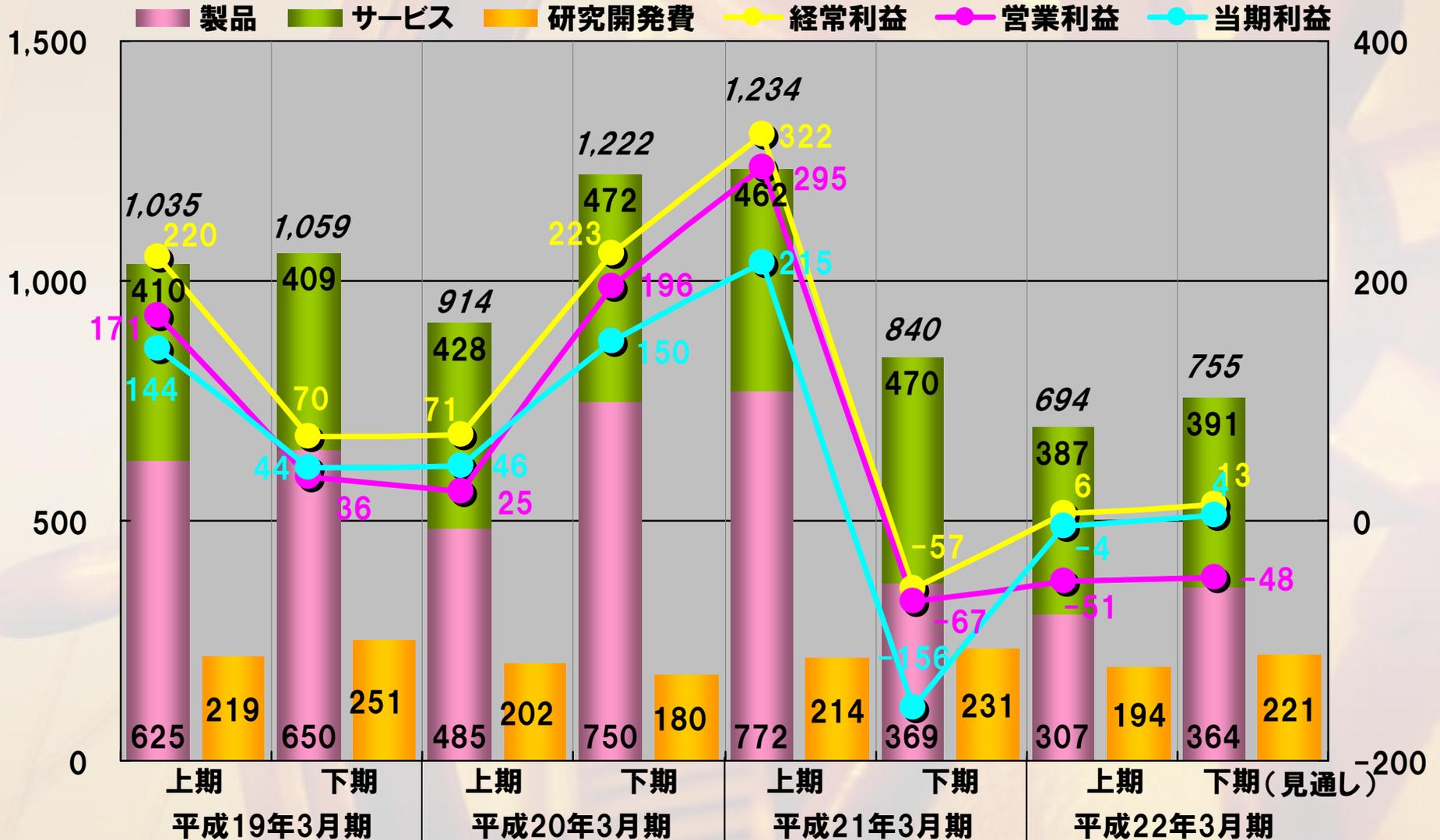
【通期比】

(単位:百万円)



半期毎売上高・利益の推移

(単位：百万円)



連結貸借対照表 - 前期比 -

(単位:百万円)

| | 平成21年 3月31日 | 平成21年 9月30日 | 差異 | | 平成21年 3月31日 | 平成21年 9月30日 | 差異 |
|----------------|----------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|----------------|------------|
| (資産の部) | | | | (負債の部) | | | |
| I 流動資産 | 1,474 | 1,466 | △7 | I 流動負債 | 379 | 410 | 31 |
| 1 現金及び預金 | 1,070 | 1,132 | 61 | 1 買掛金 | 63 | 50 | △12 |
| 2 受取手形及び売掛金 | 298 | 240 | △57 | 2 未払法人税等 | 28 | 5 | △23 |
| 3 たな卸資産 | 13 | 17 | 4 | 3 賞与引当金 | 80 | 50 | △29 |
| 4 繰延税金資産 | 39 | 23 | △16 | 4 前受金 | - | 247 | 247 |
| 5 その他 | 54 | 55 | 0 | 5 その他 | 206 | 55 | △150 |
| 6 貸倒引当金 | △3 | △2 | 0 | 負債合計 | 379 | 410 | 31 |
| II 固定資産 | 1,352 | 1,350 | △2 | (純資産の部) | | | |
| 1 有形固定資産 | 21 | 32 | 11 | I 株主資本 | 2,449 | 2,406 | △42 |
| 2 無形固定資産 | 40 | 35 | △4 | 1 資本金 | 760 | 760 | - |
| 3 投資その他の資産合計 | 1,291 | 1,282 | △8 | 2 資本剰余金 | 890 | 890 | - |
| (1) 長期貸付金 | 3 | 2 | △1 | 3 利益剰余金 | 831 | 788 | △42 |
| (2) 繰延税金資産 | 207 | 229 | 22 | 4 自己株式 | △32 | △32 | - |
| (3) 長期預金 | 1,000 | 1,000 | - | II 評価・換算差額等 | △1 | 0 | 2 |
| (4) その他 | 80 | 50 | △29 | 為替換算調整勘定 | △1 | 0 | 2 |
| | | | | 純資産合計 | 2,447 | 2,407 | △40 |
| | | | | 負債純資産合計 | 2,826 | 2,817 | △9 |
| 資産合計 | 2,826 | 2,817 | △9 | | | | |

前受金増大に伴う掲記変更

敷金回収・差入れ差額

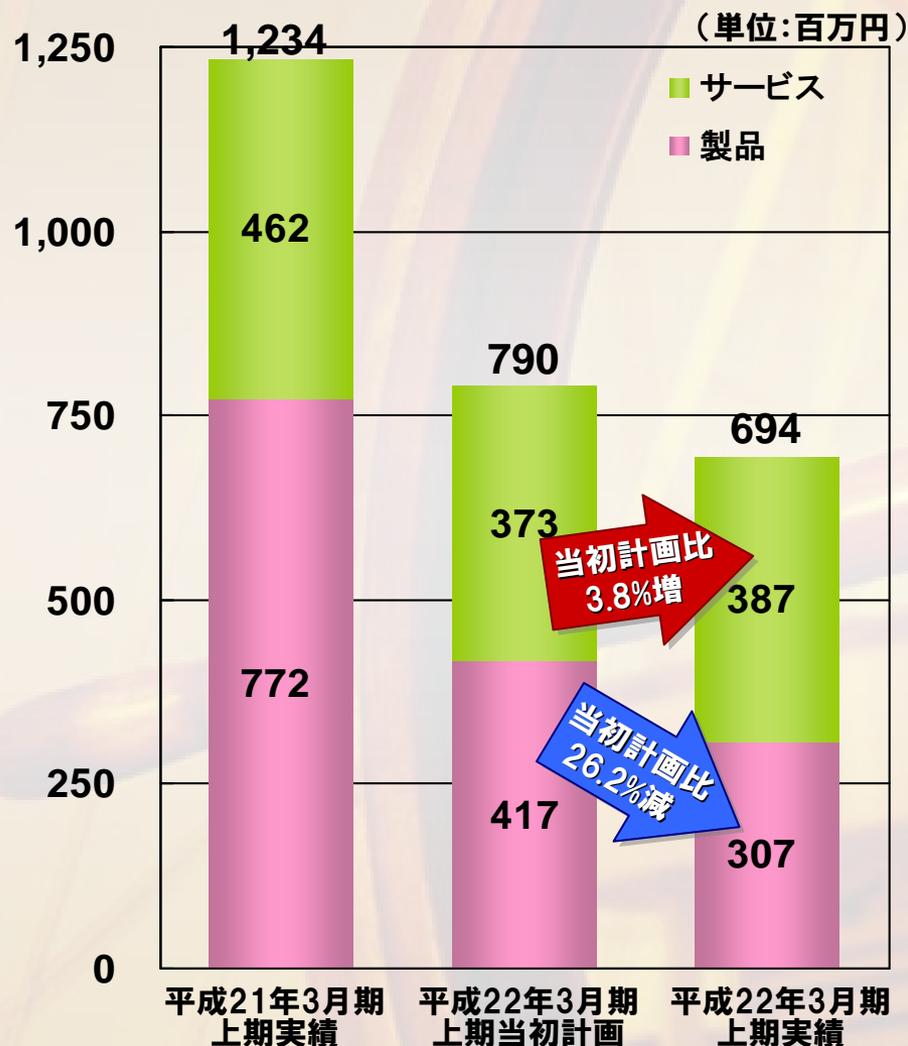
連結キャッシュフロー計算書 - 前年同期比 -

(単位:百万円)

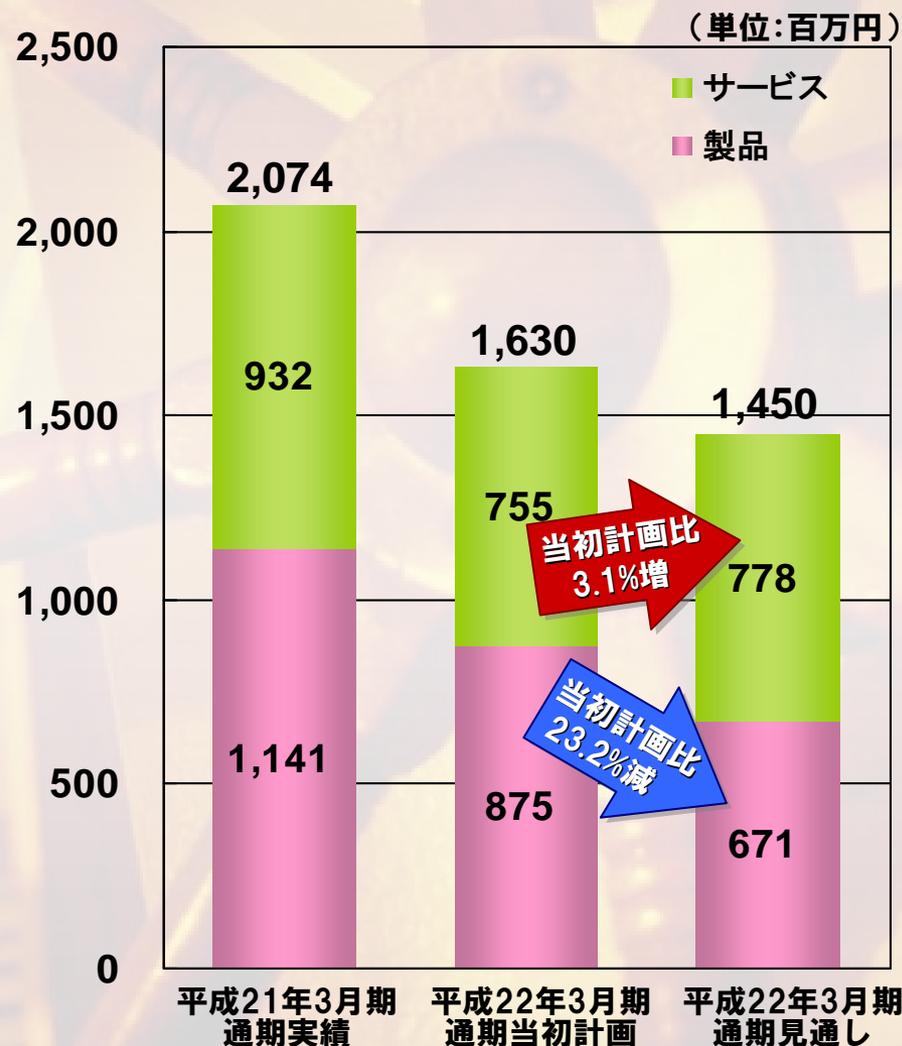
| | 平成20年4月1日 ～ 平成20年9月30日 | 平成21年4月1日 ～ 平成21年9月30日 | 差異 |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408 | 86 | △321 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 348 | 11 | 359 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 38 | △38 | — |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 2 | 2 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 (減少:△) | 20 | 61 | 40 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,348 | 1,070 | △277 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,368 | 1,132 | △236 |

事業別売上高（製品／サービス） -対計画比-

【半期比】

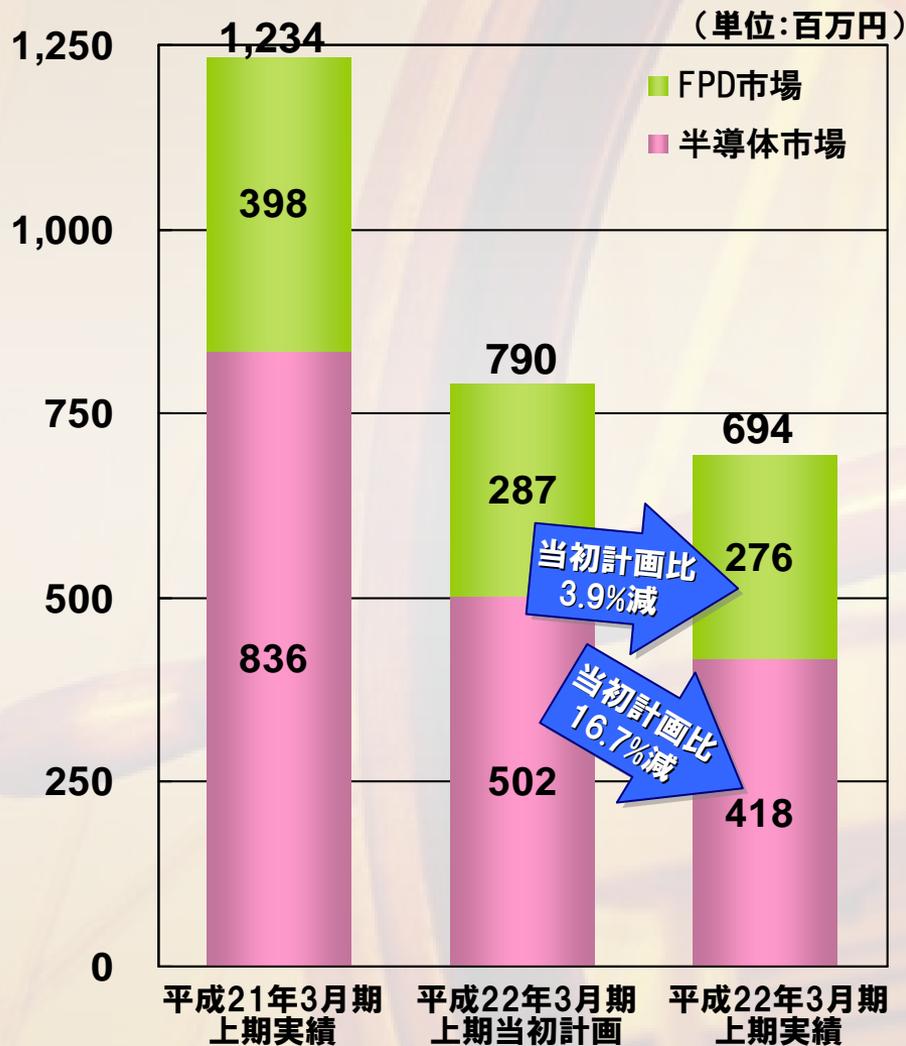


【通期比】

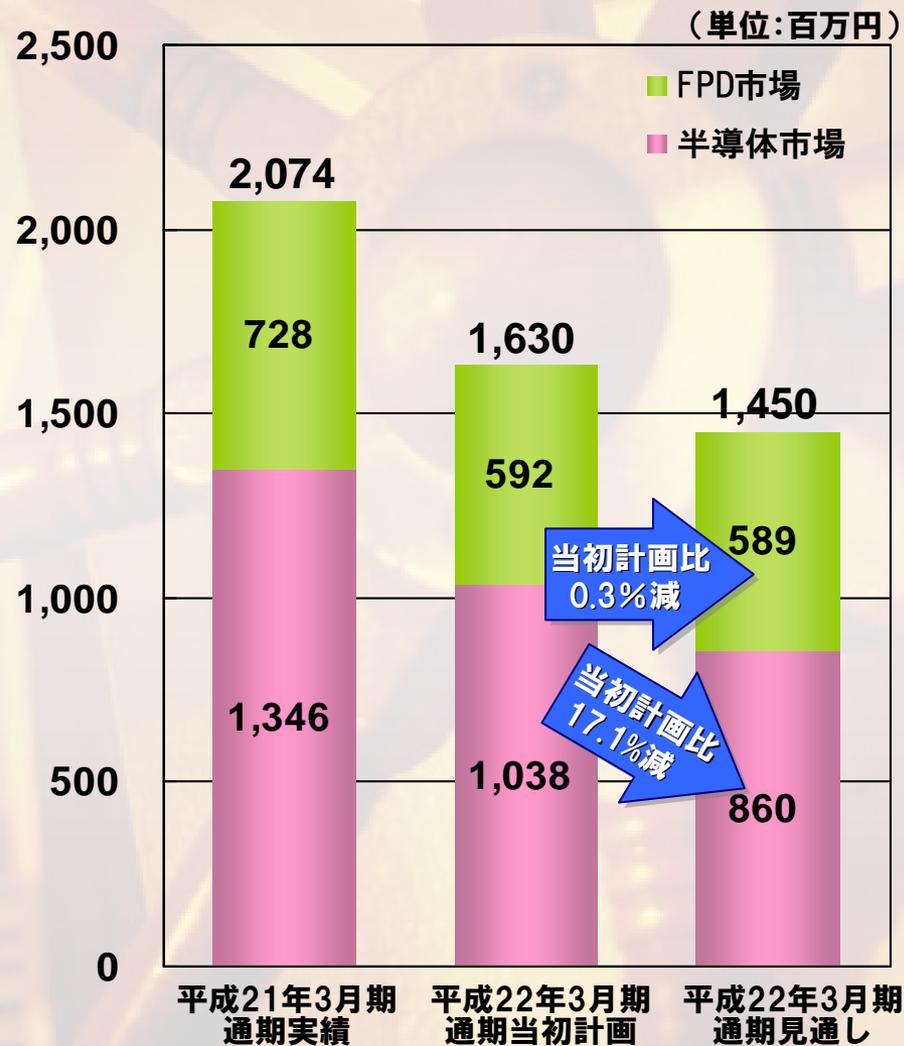


市場別売上高（半導体/FPD） -対計画比-

【半期比】



【通期比】

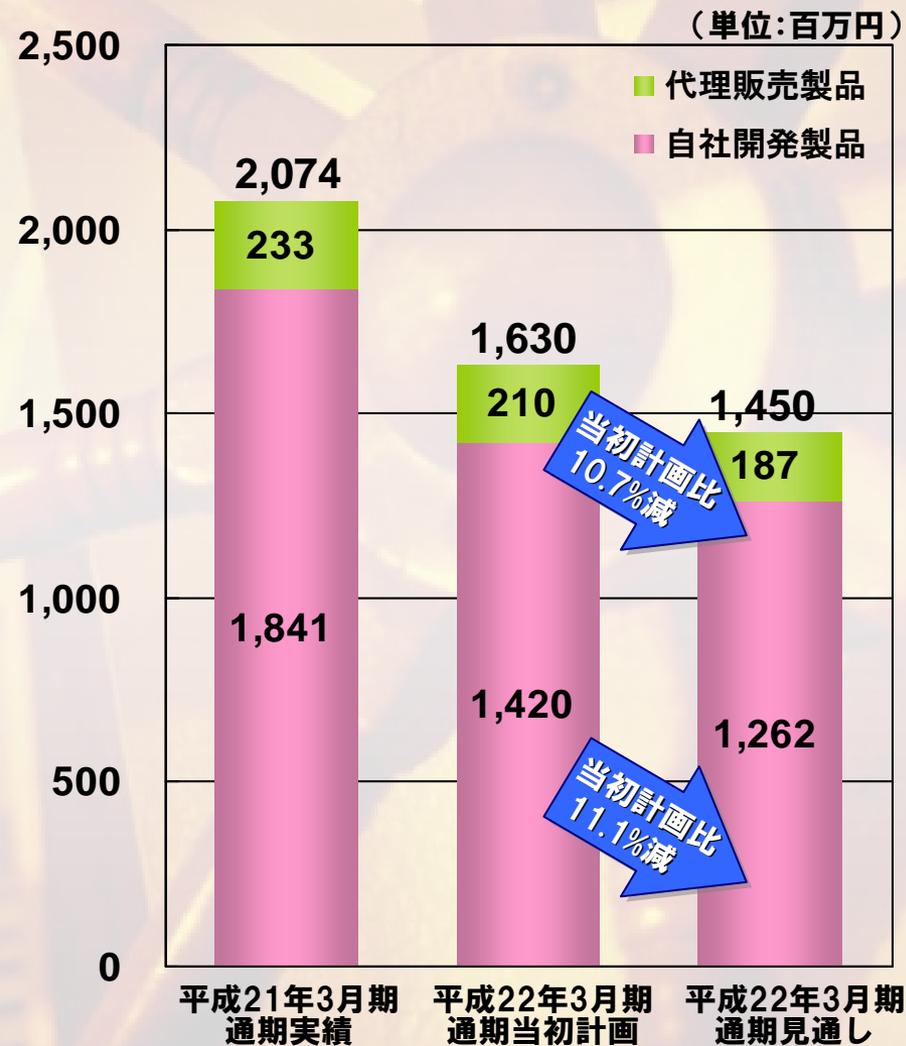


製品区分別売上高（自社開発／代理販売） -対計画比-

【半期比】



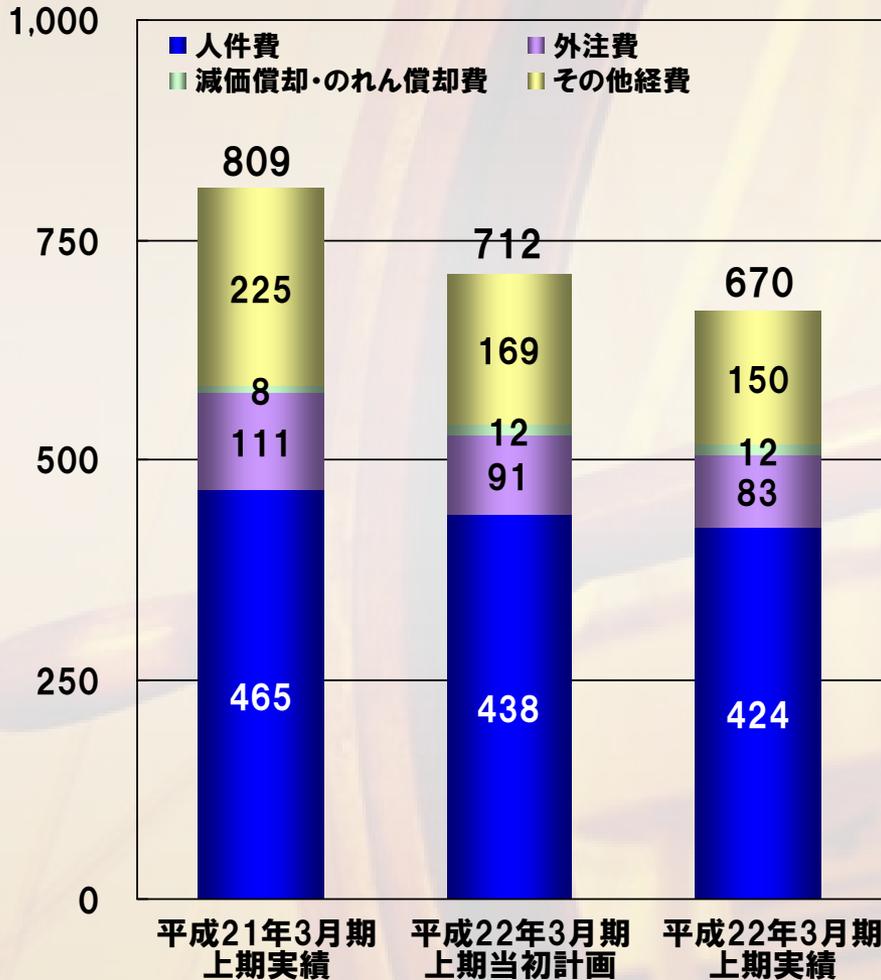
【通期比】



固定費内訳 -対計画比-

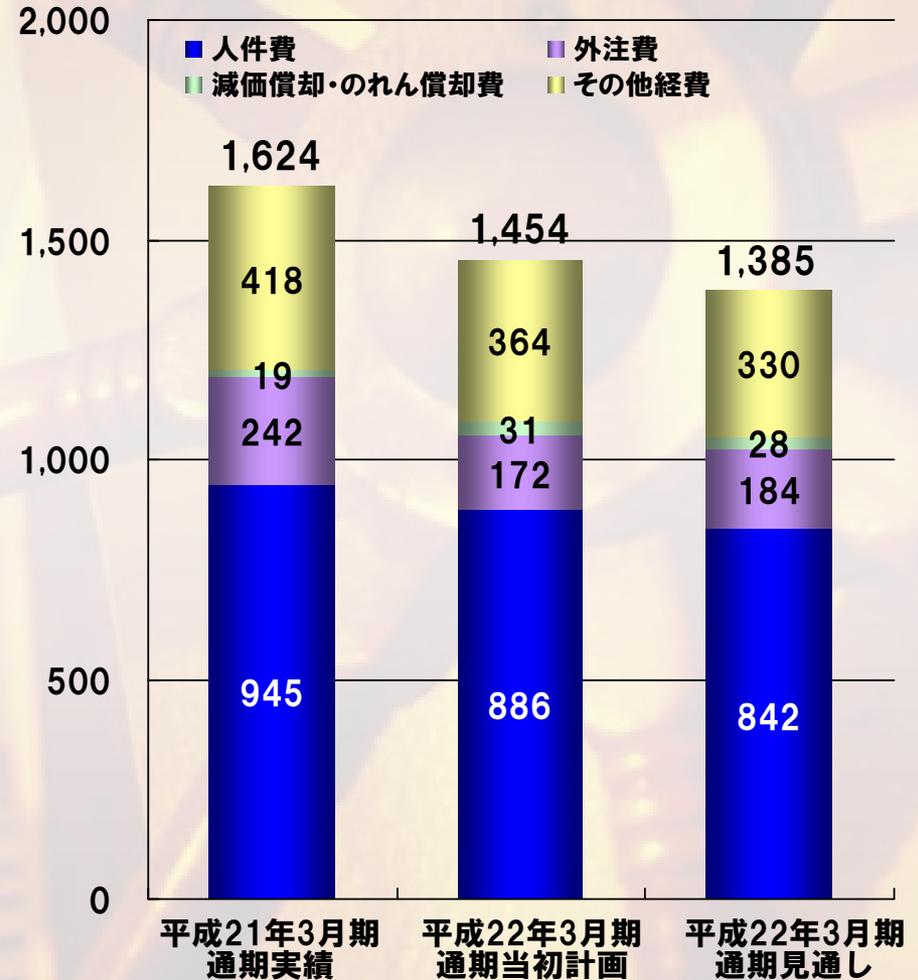
【半期比】

(単位:百万円)



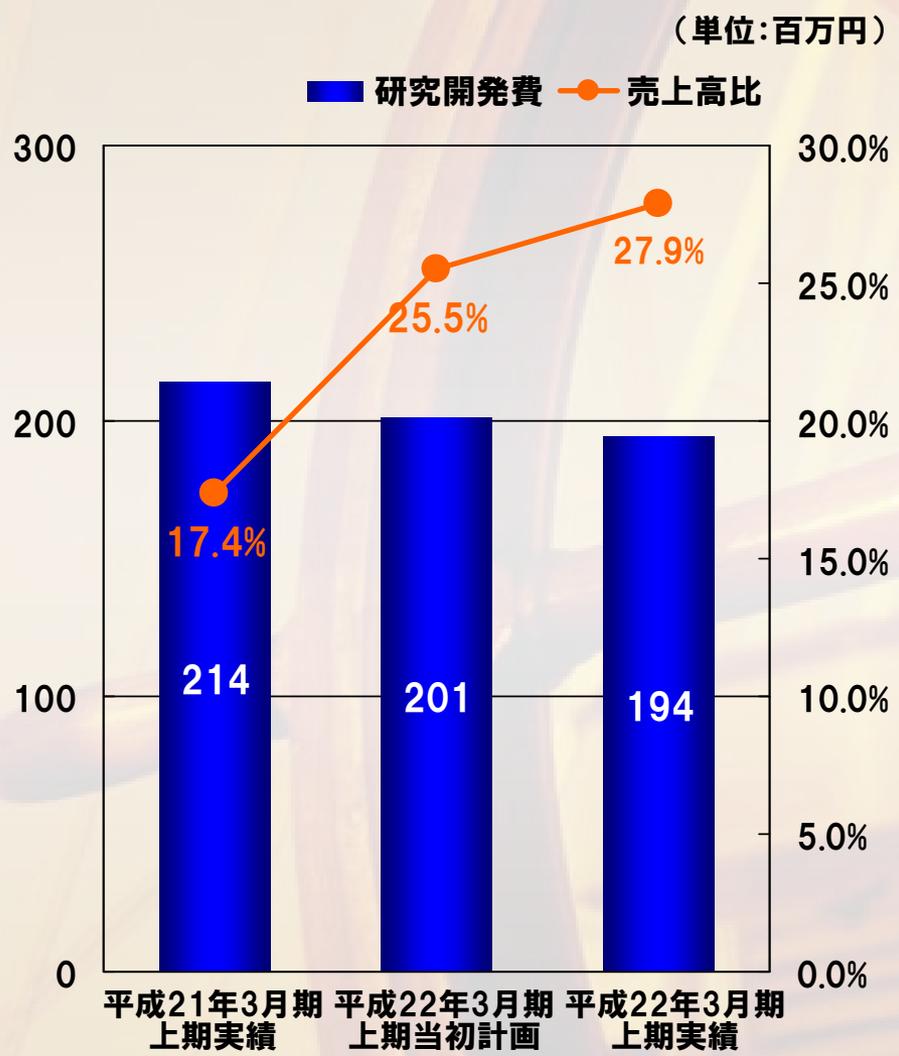
【通期比】

(単位:百万円)

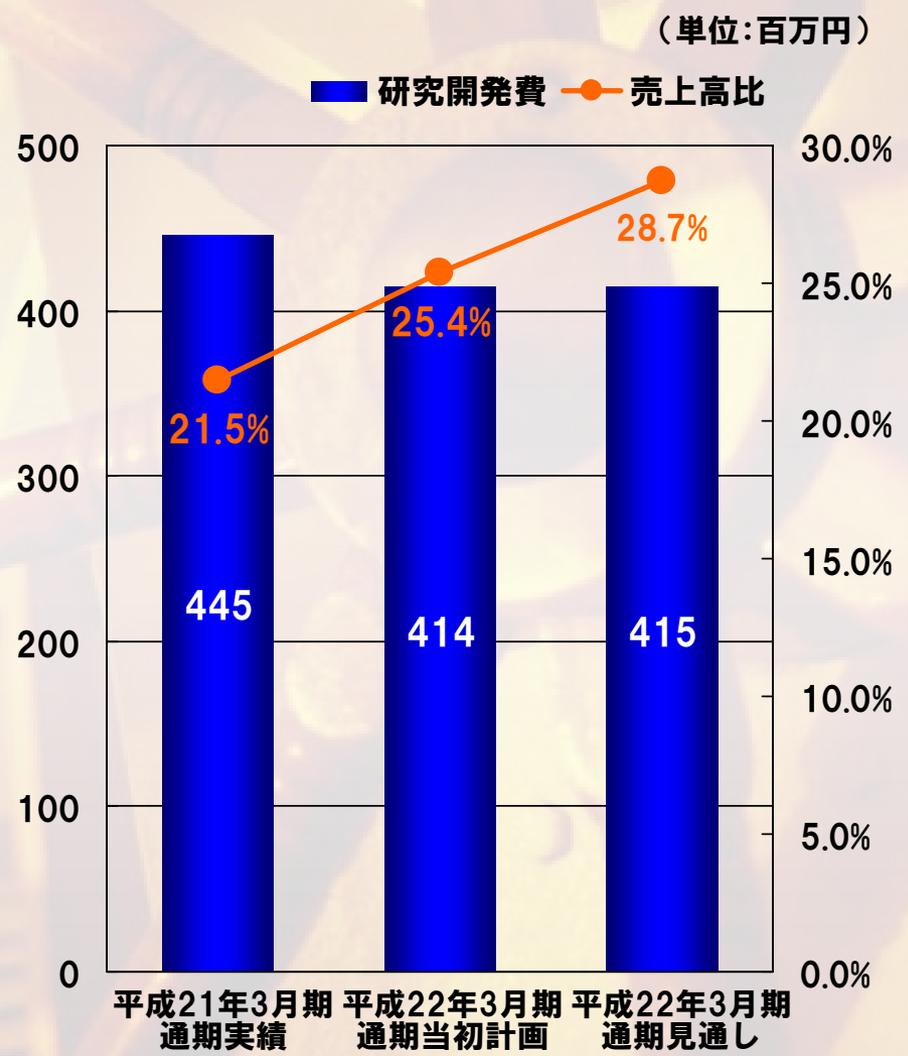


研究開発費 -対計画比-

【半期比】



【通期比】



主なトピックス（新製品関係）

- **液晶パネル設計における回路・光協調シミュレーション環境発表（7月）**
 - Jedat、Legend、Daouxiliconの3社提携
- **液晶ドライバIC／液晶パネルの拡張シミュレーション環境発表（7月）**
 - 最先端のパネル向けにパネル・ドライバ協調シミュレーションの提案
- **FPD向け高精度容量抽出：FineQap販売開始（10月）**
 - FPDパネル向けに対応した世界で唯一のツール
- **有機EL向け高精度電圧降下分布算出：FineVolt販売開始（10月）**
 - FPDパネル向けに対応した世界で唯一のツール
- **回路シミュレーション波形高速表示ツール：SpiceChart販売開始（10月）**
 - 大規模波形データの高速表示
- **統合回路設計ツール：C³ (Circuit-Cube) 販売開始（10月）**
 - シミュレーション効率大幅向上、ノウハウの継承、レイアウト品質向上

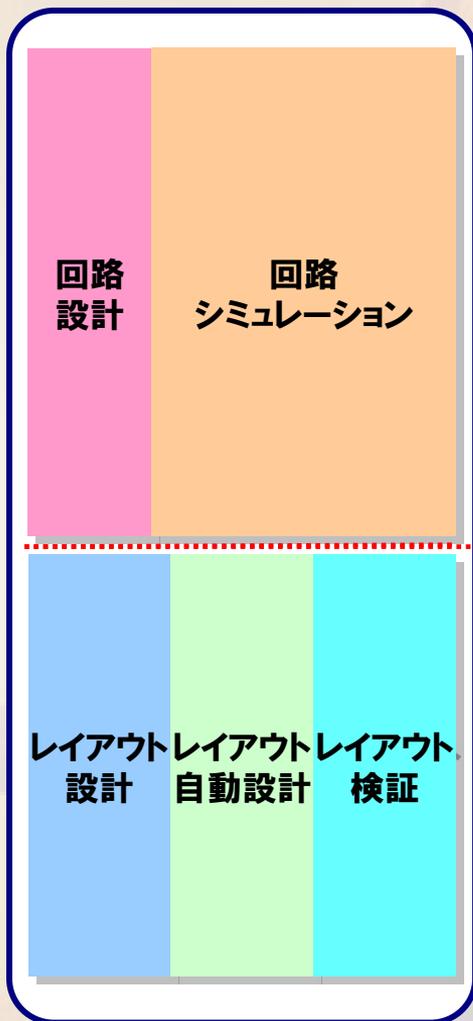
主なトピックス（イベント等）

- Model DiagnoserがTSMC社に正式採用（6月）
 - スタンダードセル検証ツール
- 主力製品：α-SX V3.5.0のリリース（8月）
 - FPD向け製品の拡充およびグローバル化の促進
- 顧客サービス強化のため本社移転（8月）
 - 共同立上げサービスに向けたプロジェクトルームを新設
- Mentor社と提携（8月）
 - Mentor社上流系製品との接続に関する提携
- プライベートショウを開催（10月）
 - 各種新製品を発表
 - 新設計移行時の障害要因とその解決事例を紹介



売上拡大に向けた施策の着実な実施1

半導体



現在、売上比の小さい(2%)回路設計分野での新製品開発を加速し2年後には比率を10%に高める

シミュレーション精度&効率UP

- C3 (Circuit-Cube) リリース
 - ・回路検証効率大幅向上
 - ・回路検証ノウハウの継承
 - ・レイアウト品質の向上
 - ・レイアウト設計との手戻り削減

競争力のあるレイアウト設計分野で売上拡大
→自動設計を取り入れた新設計手法の提案強化

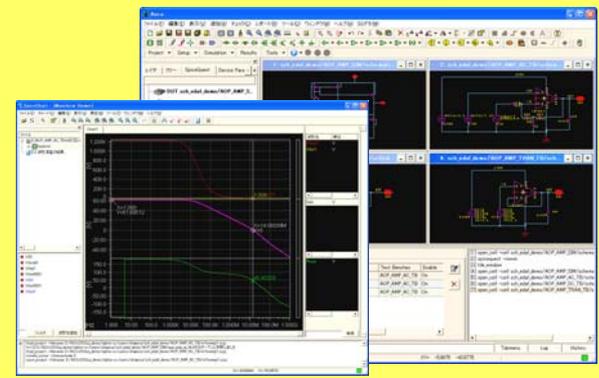
新設計手法の普及

- ベンチマーク事例による提案
 - ・プライベートフェアでの発表
→記事掲載
 - ・共同プロジェクト室を用意

戦略的新製品：C³ (Circuit-Cube)

回路設計

C³ (Circuit-Cube) 統合回路設計ツール

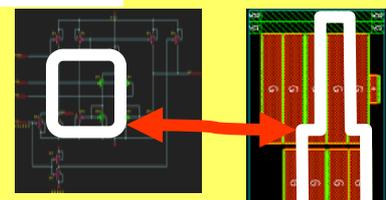


回路の検証シナリオ(手順/方法)や制約情報をデータベース化することにより、ノウハウを蓄積し再利用を行うことができる

回路設計に必要な機能を一体化することにより、効率良く設計・検証を進めることができる

回路制約情報からレイアウト制約情報を自動生成することにより、トータルな工数短縮と品質向上を実現できる

レイアウト設計



- *自動配置、配線
- *制約ドリブン編集

従来から、ジエダットが競争力を持つ分野

日経BP社TechOn! EDAサイトに紹介記事の掲載

「ユーザーの誤解を解きたい」、ジードットがカスタムICのレイアウト設計用EDAのベンチマーク結果を発表
(2009/10/26)

最新カスタムレイアウト設計環境への大きな誤解

JEDAT EDA Fair 2009

| 求められる条件 | | 主な誤解 |
|-----------------|-----|---|
| チップ面積の追求 | | <ul style="list-style-type: none"> ・サイズが小さくならない ・回路階層通りにしかレイアウトできない |
| TAT短縮 | 品質 | <ul style="list-style-type: none"> ・ネットリストがないと使えない ・編集の自由度が少ない ・編集速度が遅い |
| | 効率化 | <ul style="list-style-type: none"> ・既存資産が再利用できない ・本当に品質が上がるのか? ・自動の結果が良くない |
| コンカレント設計への確実な対応 | | <ul style="list-style-type: none"> ・デザインルール・回路変更への対応ができない |
| 新環境の早期立上げ | | <ul style="list-style-type: none"> ・準備に時間がかかる ・環境構築要員が必要 |

効果の一例

JEDAT EDA Fair 2009

| 定義: 1日/10h 素子数: 1200 | 既存環境 (ポリゴン設計手法) | α-SX 使用 (最新のレイアウト設計環境) |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 素子数/1日 | 30 | 120 |
| 面積見積りと トップフロアプラン | 3日 | 2h |
| ブロック内レイアウト | 1200/30 = 40日 | 1200/120 = 10日 (検証込み) |
| ブロック間配線 | 5日 | 3h |
| トップ検証 | 3日 | 0.5日 |
| Total | 51日 | 11日 |

売上拡大に向けた施策の着実な実施2

FPD

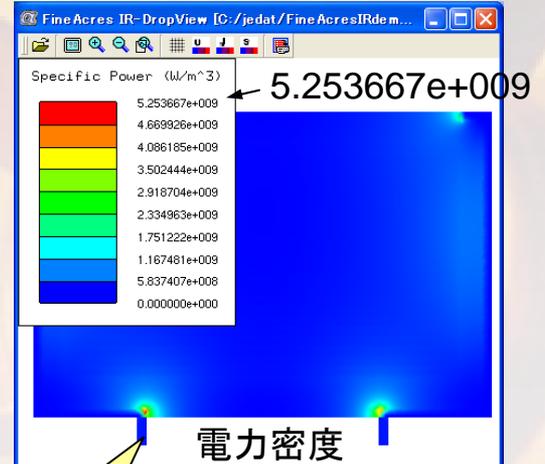
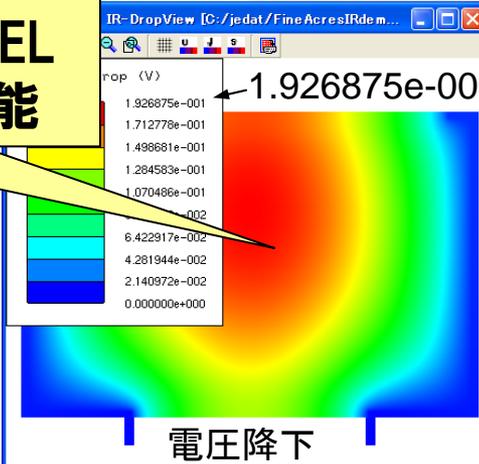
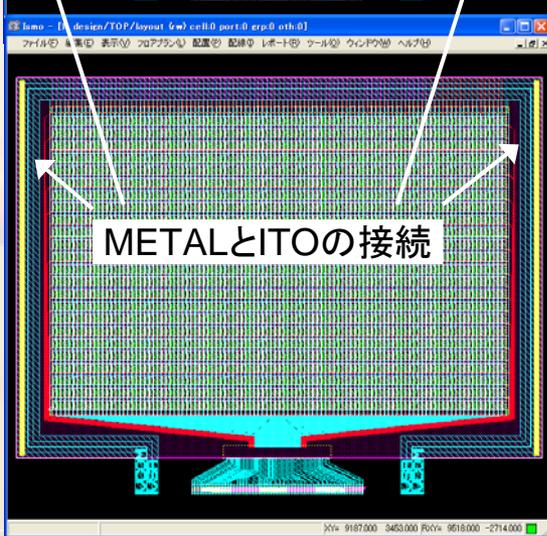
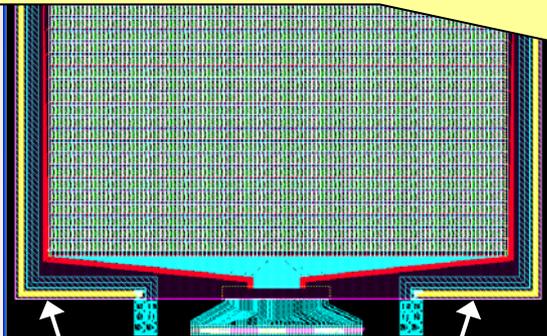


強みを活かした総取り戦略

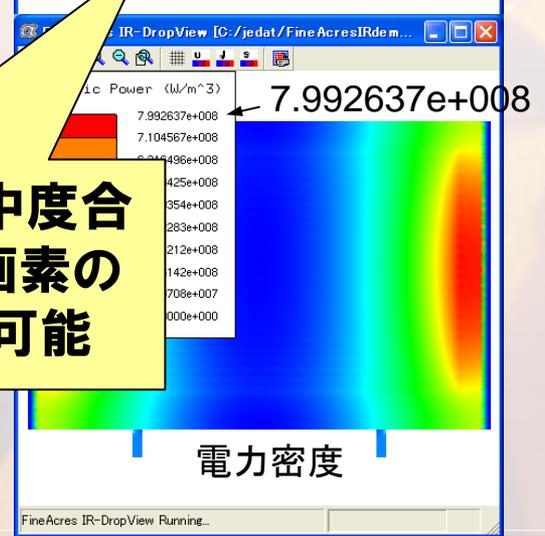
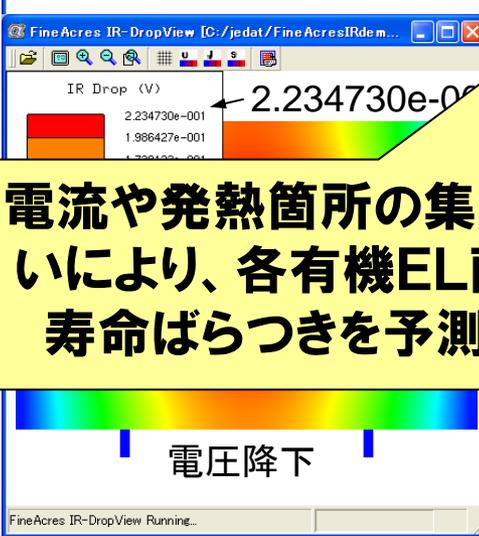
- **FPD向け回路・光協調シミュレーション環境リリース**
 - ・光の動作を確認しながら回路検証を実施可
 - ・世界初
- **FPD向け高精度容量抽出: FineQapリリース**
 - ・従来の半導体向け容量抽出ツールでは誤差大
 - ・高速高精度3次元抽出
 - ・FPD向けとして世界初
- **有機EL向け電圧降下分布算出: FineVoltリリース**
 - ・有機ELパネルの画素間寿命ばらつきの均一化
 - ・高速高精度
 - ・有機EL向けとして世界初

有機EL向け電圧降下算出: FineVolt

電圧降下の様子から有機EL
の表示ばらつきを予測可能



電流や発熱箇所の集中度合いにより、各有機EL画素の
寿命ばらつきを予測可能



売上拡大に向けた施策の着実な実施3

現在の海外販売比率5%を3年後には20%に上げる

中国FPD市場拡大へ

の対応(α-SX)

- サポート体制の強化と販売代理店支援強化
- 北京R&D子会社→事業拠点
- 上海にサポート拠点

韓国FPD市場、台湾FPD市場の

拡販(α-SX)

- 販売代理店の支援強化
- 他社では出来ないこと(高精度高速抵抗・容量計算)から入る



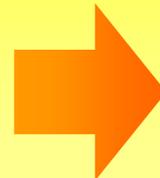
実施済

今後、成果につなげていく

売上拡大に向けた施策の着実な実施4

韓国半導体市場の拡販(α-SX)

- アナログLSI, メモリ、ドライバーをターゲット
- 自動設計を取り入れた新設計手法の提案
- 販売代理店の支援強化

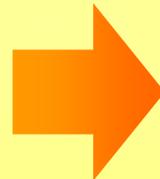


実施中

**上流(回路)設計
ツールの充実により、
今後加速**

HOTSCOPEの拡販

- 世界中の半導体市場をターゲット
- 販売代理店の増強



実施中

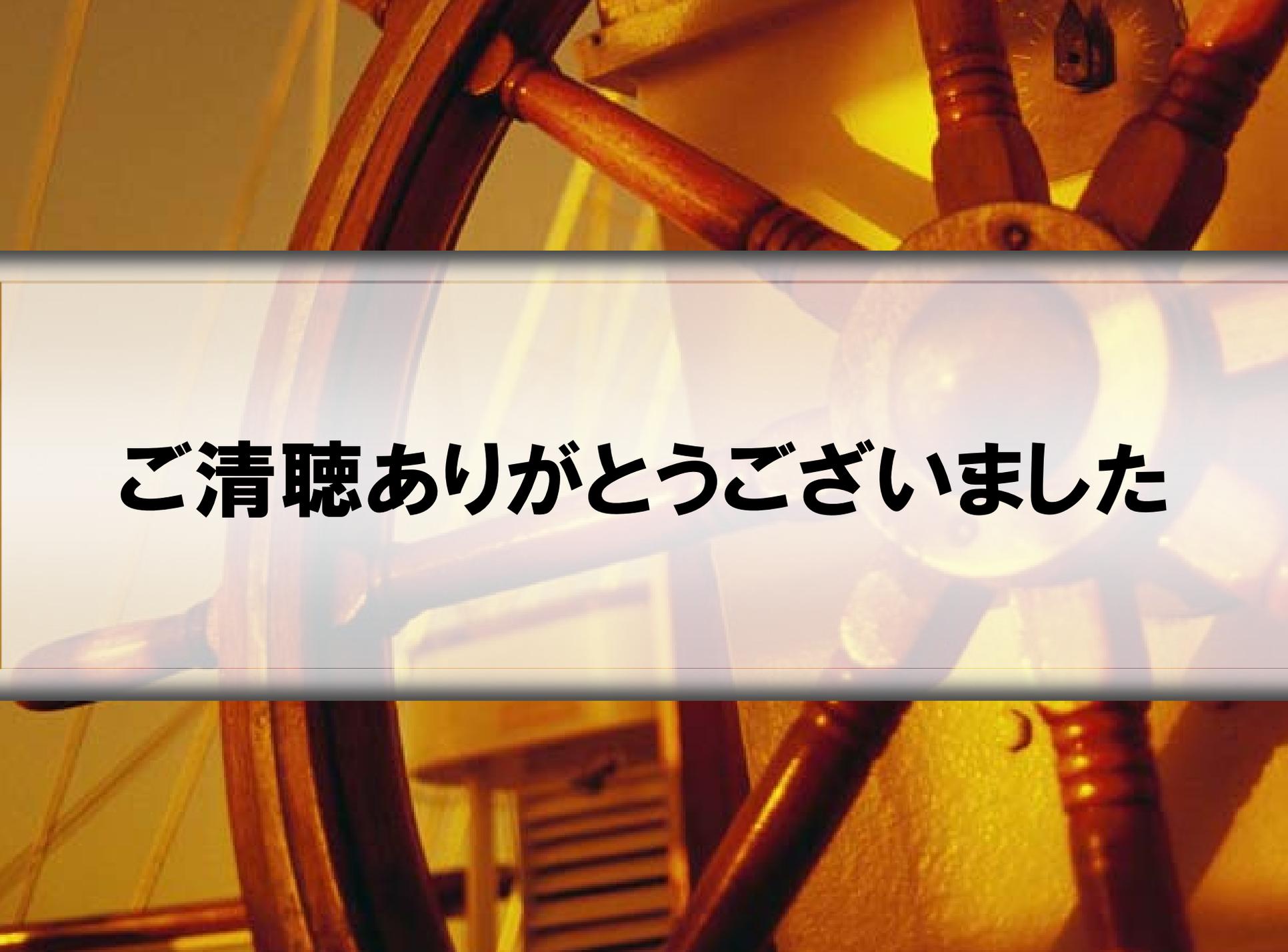
米国・欧州半導体市場の拡販(α-SX)

- アナログLSIをターゲット
- 自社AEを置く



未着手

本年は様子見



ご清聴ありがとうございました